下载日志已记录，仅供内部参考



强于大市

电子材料行业 2026 年中报综述及展望

AI 算力需求高增与国产替代加速共振，材料龙头业绩兑现加速

受 AI 基础设施、高性能计算与先进存储投资高景气延续，以及半导体材料涨价进一步向报表端传导的双重驱动，叠加新建产能陆续释放、国产化持续推进，材料企业收入端预计维持较快增长，其中先进制程及先进封装相关材料、国产替代兑现节奏较快的品类有望延续领跑态势。我们认为电子材料领域有望持续迎来发展良机，维持行业*强于大市*评级。

支撑评级的要点

- **行业景气度：AI 驱动半导体高景气，材料量价齐升、国产替代加速。**WSTS 预计 2026 年全球半导体市场规模达 1.655 万亿美元（同比+108%）、26H1 达 7,020 亿美元（同比+102%），存储器为增长核心；2025 年全球半导体材料销售额 732 亿美元（同比+6.8%），预计 2030 年将达 1,302 亿美元。2026 年以来全球半导体材料掀起涨价浪潮，且本轮涨价范围已经由点到面从关键化工原料扩散至制造全链条。我们认为，本轮半导体材料涨价原因包括需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振。另一方面，我国电子材料国产替代持续推进。
- **电子材料行业 26H1 业绩综述：1）营业总收入：规模稳健增长，量价共振增厚收入。**根据我们建立的电子材料行业 69 家标的库（详见正文图表 9），26H1 营收合计 783.21 亿元（同比+28.97%），26Q2 同比+31.99%、环比+16.86%，主要系 AI 算力与先进存储需求扩张带动下游晶圆厂产能释放、国产替代加速带来份额提升、部分材料进入涨价通道。**2）归母净利润：26Q2 盈利改善提速，利润弹性集中于 AI 链及国产替代龙头。**26H1 合计 65.09 亿元（同比+24.11%），62 家盈利、7 家亏损，26Q2 同比+43.98%、环比+52.00%，盈利改善斜率快于收入。**3）毛利率与净利率：结构性分化显著。**26H1 整体毛利率/净利率为 25.06%/8.43%（同比-0.70pct/-0.24pct）。**4）研发费用：高端材料品类持续加大开发与验证投入。**26H1 合计 48.05 亿元（同比+24.85%），研发费用率 6.14%，近三年电子材料行业整体研发费用率均维持在 6%以上，鼎龙股份、安集科技等龙头企业的研发费用率超过 15%，持续投入为高端材料国产化突破夯实技术基础。**5）资本开支：扩张节奏平稳、投资强度企稳，龙头加码先进产能与新品布局。**26H1 合计 135.66 亿元（同比+4.84%），占期末固定资产净额比重 11.12%（同比-1.38pct），投资强度自 2022 年高点回落，滚动 12 个月口径 23.88%呈现企稳迹象。**6）龙头业绩增速更快，利润贡献与集中度较高。**我们选取的 24 家市值 300 亿元以上标的 26H1 营收及归母净利润增速均高于 69 家整体，且占比同比提升；从 26H1 较 25H1 增量贡献看，24 家标的占 69 家营收、归母净利润增量的比重分别达 55.38%、67.03%。**以上标的中报值得关注的变化：一是 AI 算力与国产替代共振，材料龙头业绩兑现加速；二是重资产环节收入高增、盈利仍在修复；三是新品类与全球布局提速。**
- **电子材料行业 2026 年下半年及未来展望：需求端：AI 与存储高景气有望延续，先进技术迭代促进材料需求持续扩大。**全球半导体市场有望继续维持高增速，对晶圆制造材料与封装材料的消耗量有望持续提升。中长期来看，先进技术迭代促进材料需求持续扩大，先进制程与先进封装共同推动材料用量与品类扩容，例如雅克科技前驱体材料所应用的 ALD 工序数量持续上涨——存储领域 2D NAND 向多层 3D NAND 升级使 ALD 工艺步骤近乎翻倍，逻辑领域 7nm 及以下 GAA 节点 ALD 工序进一步成倍提升。**价格端：部分材料进入涨价周期，盈利弹性有望逐渐释放。**本轮半导体材料涨价已覆盖硅片、电子特气、靶材、湿电子化学品、封装材料等多个核心品类，我们预计材料涨价带来的相关效益有望在 2026 年下半年逐渐体现。从盈利弹性来看，电子特气、溅射靶材等高壁垒品类龙头（如中船特气、江丰电子等）盈利弹性较大，此外大硅片赛道（如沪硅产业、西安奕材等）企业的毛利率有望在 2026 年下半年环比修复。**市占率：材料国产化加速推进，平台化、国际化布局持续深化。**本轮下游高景气叠加部分海外供应波动，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。例如钨、镓、锗、高纯钽相关两用物项出口管制细则落地执行，倒逼海外晶圆厂主动加大国产靶材导入比例。此外，电子材料企业向平台化产业链配套转型，并持续深化国际化布局。例如鼎龙股份抛光垫、抛光液、清洗液及高端晶圆光刻胶协同发展，并拓展大硅片、SiC、先进封装用 TSV 等新应用场景；安集科技围绕化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大产品平台及上游关键原材料持续布局，提升一站式服务能力；雅克科技覆盖半导体前驱体、光刻胶及配套试剂、硅微粉、电子特气等，已构建中韩双研发部门，韩国子公司 UP CHEM 三工厂预计 2026 年底全面投产、第四工厂已启动规划。

投资建议

- **基于下游行业快速发展、先进技术不断迭代以及国产替代大背景，我们认为电子材料领域有望持续迎来发展良机。**

  1、受益于下游需求增长以及技术不断进步，全球半导体材料市场规模持续扩大，先进材料需求快速提升。在多种关键半导体材料方面，我国企业稳健布局产能与技术研发，竞争力与产销规模有望持续提升。

  2、部分半导体材料及原料受益于涨价，下游高景气叠加海外龙头扩产速度较慢、受到原材料供应波动等影响，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。

  推荐：**安集科技、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技、彤程新材、沪硅产业、德邦科技、阳谷华泰**；建议关注：**国瓷材料、华特气体、联瑞新材、中船特气、中巨芯、西安奕材、广钢气体、昊华科技等**。

评级面临的主要风险

- 技术升级迭代的风险，下游需求复苏不及预期的风险，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力的风险。

相关研究报告

《化工行业周报 20260920》20260921
《化工行业周报 20260913》20260914
《化工行业周报 20260906》20260906

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

基础化工

证券分析师：余嫄嫄
(8621)20328550
yuanyuan.yu@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：范琦岩
qiyan.fan@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300525040001

下载日志已记录，仅供内部参考

目录

2026 年上半年电子材料行业整体表现复盘 4

2026 年以来板块走势跑赢市场 4
行业景气度：AI 驱动半导体高景气，材料量价齐升、国产替代加速 4
营业总收入：规模稳健增长，量价共振增厚收入 12
归母净利润：26Q2 盈利改善提速，利润弹性集中于 AI 链及国产替代龙头 13
毛利率与净利率：结构性分化显著 13
研发费用：高端材料品类持续加大开发与验证投入 14
资本开支：扩张节奏平稳、投资强度企稳，龙头加码先进产能与新品布局 15
龙头业绩增速更快，利润贡献与集中度较高 16

电子材料行业 2026 年下半年及未来展望 18

投资建议 19

风险提示 20

下载日志已记录，仅供内部参考

图表目录

图表 1. 2020.1.1-2026.9.30 申万半导体材料指数、申万电子化学品指数与沪深 300 指数 4
图表 2. 2020-2029E 全球半导体市场规模 5
图表 3. 2023-2026Q2 全球半导体分季度营收 5
图表 4. 2021-2025 年全球半导体材料市场销售额 6
图表 5. 2025 年全球分地区半导体材料市场销售额 6
图表 6. 部分关键半导体材料涨价情况梳理 7
图表 7. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报） 8
续 图表 7. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报） 9
续 图表 7. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报） 10
图表 8. 国内部分企业先进封装材料项目进展（截至 2026 年中报） 11
图表 9. 本报告电子材料行业 69 家标的库包含标的（截至 2026.9.30） 12
图表 10. 2022-26H1 电子材料行业营业总收入及同比 12
图表 11. 2022-26H1 电子材料行业归母净利润及同比 13
图表 12. 2022-26H1 电子材料行业毛利率、净利率 14
图表 13. 2022-26H1 电子材料行业研发费用及同比 15
图表 14. 2022-26H1 电子材料行业研发费用率 15
图表 15. 2022-26H1 电子材料行业资本开支及同比 16
图表 16. 2022-26H1 电子材料行业固定资产及同比 16
图表 17. 2021-2025 年电子材料行业资本开支/固定资产比例 16
图表 18. 市值 300 亿元以上标的 2026 年中报业绩（总市值截至 2026.9.30） 17

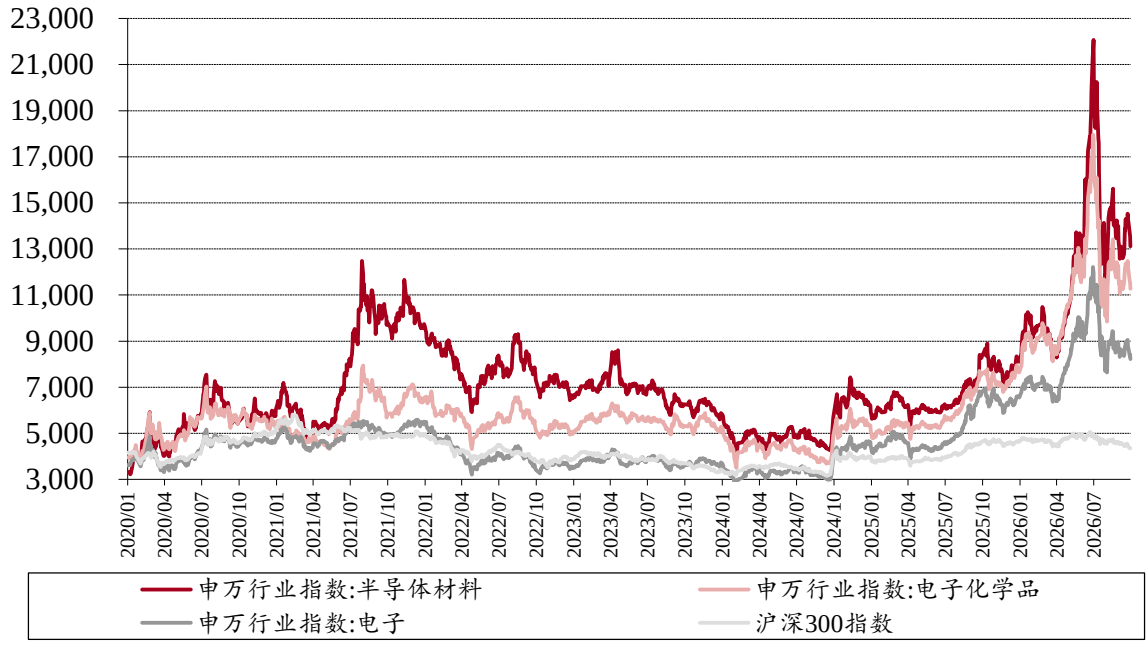
下载日志已记录，仅供内部参考

2026 年上半年电子材料行业整体表现复盘

2026 年以来板块走势跑赢市场

根据万得的数据，截至 2026 年 9 月 30 日，申万半导体材料指数年内累计涨幅为 61.83%，跑赢沪深 300 指数/申万电子指数 67.71/36.36pct；申万电子化学品指数年内累计涨幅为 47.41%，跑赢沪深 300 指数/申万电子指数 53.29/21.94pct。

图表 1. 2020.1.1-2026.9.30 申万半导体材料指数、申万电子化学品指数与沪深 300 指数



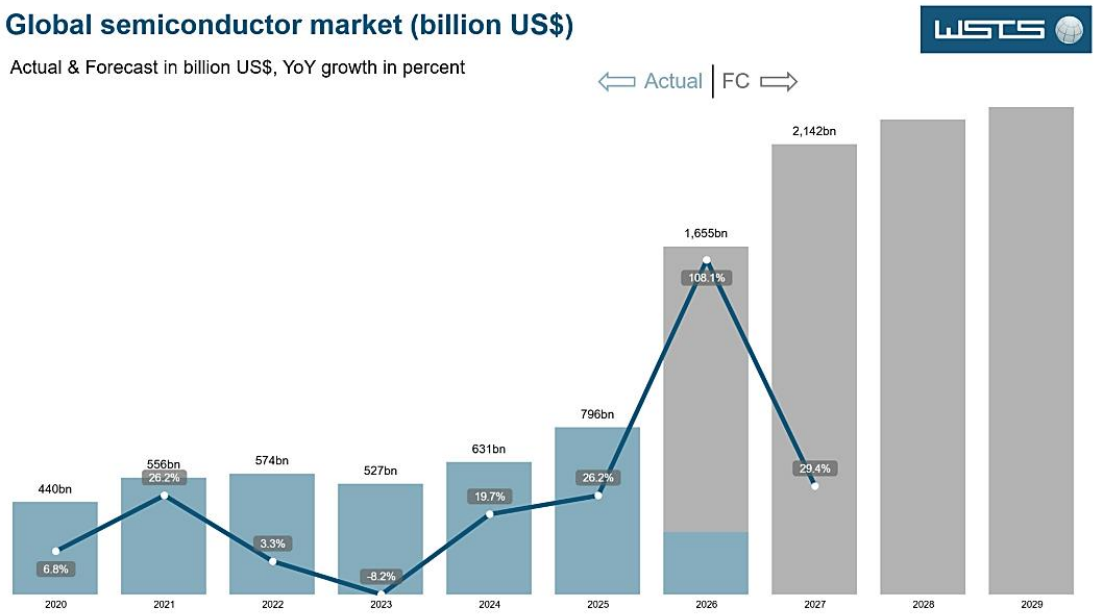
资料来源：万得，中银证券

行业景气度：AI 驱动半导体高景气，材料量价齐升、国产替代加速

全球半导体市场持续受 AI 基础设施建设带动迎来高速增长。全球半导体贸易统计组织（WSTS）公布 2026 年第二季度统计数据，预计 2026 年全球半导体市场规模将达到 1.655 万亿美元，同比增长 108%，较此前春季预测的增速 89.9%进一步上调。数据显示，26H1 全球半导体市场规模达 7,020 亿美元，同比增长 102%，其中 26Q2 半导体营收达 4,030 亿美元，同比增长 124%，市场增长主要受人工智能基础设施、高性能计算以及先进存储技术投资推动。从产品类别来看，存储器成为增长核心。WSTS 数据显示，26H1 存储器市场营收同比增长 305%，预计全年将增长 302%，高于此前预测的 249%。逻辑芯片同样表现强劲，26H1 营收同比增长 45%。WSTS 表示，除传感器外，2026 年各主要半导体产品类别预测均有所上调。随着 AI 服务器、数据中心和先进计算需求持续增长，GPU、HBM、先进 DRAM 等产品成为市场重要增长动力。展望未来，WSTS 预计 2027 年全球半导体市场规模将达约 2.14 万亿美元，同比增长约 29%，续创历史新高。区域方面，美洲和亚太地区预计将继续保持较快增长。根据雅克科技 2026 年中报，中国半导体市场在政策支持和国产替代推动下，预计 2026 年市场规模 8,120.8 亿美元，较 2025 年的 4,210 亿美元同比增长 92.9%，显示出强劲增长趋势。

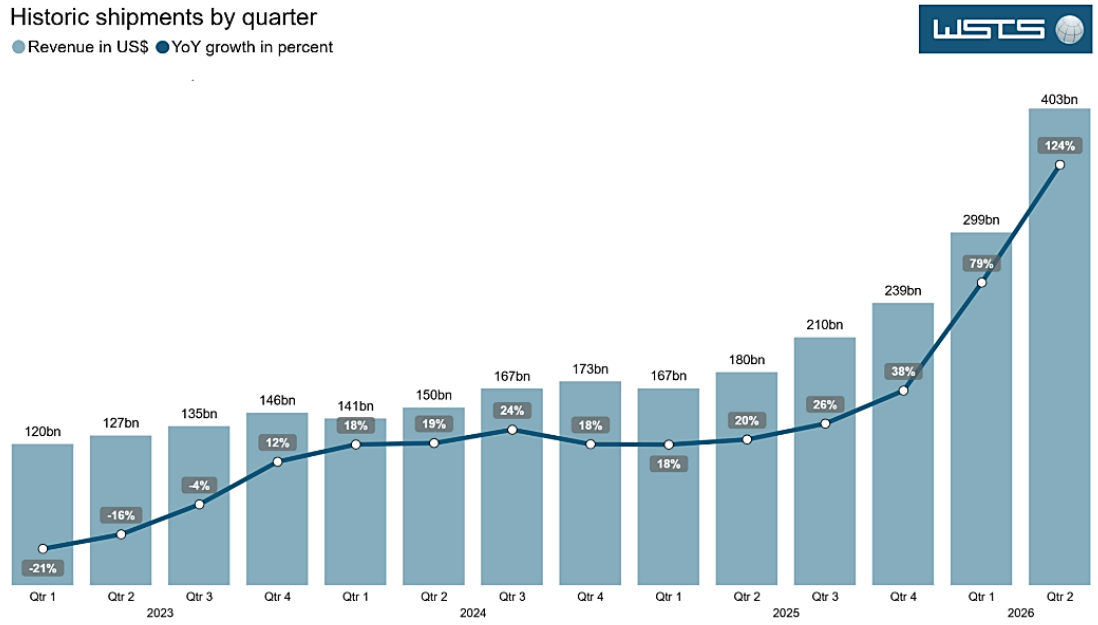
下载日志已记录，仅供内部参考

图表 2. 2020-2029E 全球半导体市场规模



资料来源：WSTS，中银证券

图表 3. 2023-2026Q2 全球半导体分季度营收

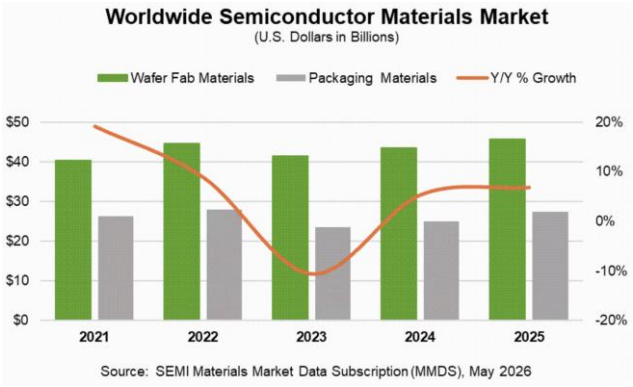


资料来源：WSTS，中银证券

半导体材料市场规模续创新高。根据 SEMI、安集科技 2026 年中报以及灼识咨询报告，全球半导体材料市场规模持续扩容，2025 年全球半导体材料市场销售额为 732 亿美元，同比增长 6.8%，预计 2030 年将达到 1,302 亿美元。其中，晶圆制造材料 2025 年市场规模为 459 亿美元，2030 年增长至 851 亿美元，2025-2030 年 CAGR 为 13.1%；封装材料 2025 年市场规模为 273 亿美元，预计 2030 年增至 451 亿美元，2025-2030 年 CAGR 为 10.6%。分地区来看，中国台湾地区连续第 16 年保持全球最大半导体材料消费地区位置，2025 年销售额达 217 亿美元；中国大陆以 156 亿美元的销售额排名第二；韩国以 112 亿美元销售额排名第三。除欧洲外，所有地区均实现同比增长，中国和北美在主要地区中增长最强。我们认为，受益于半导体产业长期发展趋势，全球半导体材料市场规模有望保持增长态势，随着逻辑、存储器件向先进节点演进，以及三维集成和先进封装需求的快速增长，晶圆制造材料和封装材料需求有望持续提升。

下载日志已记录，仅供内部参考

图表 4. 2021-2025 年全球半导体材料市场销售额



资料来源：SEMI，中银证券

图表 5. 2025 年全球分地区半导体材料市场销售额

Semiconductor Materials Market Revenue by Region

(U.S. Dollars in Billions)

Region	2025	YoY % Growth
North America	$6.2	10.7%
Europe	$4.2	-6.0%
Japan	$6.8	2.3%
Chinese Taiwan	$21.7	8.6%
South Korea	$11.2	2.4%
Chinese Mainland	$15.6	12.5%
ROW	$7.5	6.7%
Total	**$73.2**	**6.8%**

Source: SEMI Materials Market Data Subscription (MMDS), May 2026

资料来源：SEMI，中银证券

多种半导体材料进入涨价周期。2026 年以来全球半导体材料掀起涨价浪潮（详见我们于 2026 年 8 月发布的《半导体材料涨价深度报告》），且本轮涨价范围已经由点到面从关键化工原料扩散至制造全链条，覆盖硅片、电子特气、湿电子化学品、靶材、封装材料等几乎所有核心品类，形成全产业链价格上行态势。我们认为，本轮半导体材料涨价原因包括需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振。首先，AI 算力需求高增拉动半导体全产业链需求，全球半导体市场规模大幅增长；半导体材料需求直接受益于下游晶圆厂扩产周期，且 AI 浪潮大幅提升了上游材料消耗量。其次，中东事件对全球供应链与能源成本产生影响，能源价格波动传导至化工原料与部分电子材料制造成本，红海航道扰动推高国际物流成本。例如，位于日本的全球硅片与光刻胶龙头公司因成本等原因开启本轮涨价。此外，由于供给端硬约束+AI 需求高增，金属价格走强，算力金属集体涨价。例如，受化工品、算力金属等原材料以及生产成本上涨影响，靶材、电子级氢氟酸等产品涨价；受原材料出口管制以及海外供应扰动影响，六氟化钨、氦气等产品价格出现上涨。地缘政治或成为半导体材料定价的核心矛盾，我们认为本轮涨价周期区别于以往单纯需求拉动，部分材料呈现“管制触发-产能断供-价格跳涨-传导加速”的特征。

下载日志已记录，仅供内部参考

图表 6. 部分关键半导体材料涨价情况梳理

材料	涨价情况	涨价原因	境外主要生产企业	中国大陆主要生产企业	国产化率
硅片	1、2026 年 5 月信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价，其中 12 英寸常规硅片涨价 5%-8%，适配 AI/HPC 场景的高端专用硅片涨幅达 18%-22%。在 12 英寸硅晶圆领域，26Q3 抛光片均价预计将达 80 美元，外延片则达 100 美元以上；8 英寸硅晶圆继 26Q2 调涨个位数百分比后，26Q3 预计维持同等涨幅。 2、6 月 12 日立昂微对客户发出产品价格调整通知函，对全系列产品进行涨价；对于旗下半导体硅片业务，立昂微旗下金瑞泓表示，鉴于上游原材料成本上涨导致成本提升，公司决定自 7 月 1 日起，对金瑞泓硅片业务价格上调 10%-15%。	需求增长、供给受限、成本上升	信越化学、SUMCO、环球晶圆、Siltronic、SK 集团等	沪硅产业、西安奕材、立昂微、TCL 中环、上海合晶、神工股份、有研硅等	12 英寸约 35%
六氟化钨	2026 年 8 月我国六氟化钨出口 45 吨，环比减少 34.7 吨，降幅 44%（8 月受台风天气影响，部分海外订单出口船期积压、物流交付延后）；同比增加 21.6 吨，增幅 92%;2026 年 1-8 月,国内六氟化钨累计出口 380.5 吨，同比增长 44%。8 月当月出口均价 1,640 元/千克，环比上涨 4%。	上游钨粉原料价格走高；相关管控政策落地，加剧全球供给紧张格局	关东电化、中央硝子等	中船特气、昊华科技、中巨芯	65%+
氦气	2026 年国产管束高纯氦气市场均价最高涨至 497.5 元/立方米，进口管束高纯氦气均价高达 515 元/立方米；然而随着俄罗斯对华出口政策出现松动，氦气价格已从高点回落。8 月进口管束氦气市场均价为 125.79 元/立方米，环比下跌 20.37%，同比上涨 27.71%；国产管束氦气市场均价为 103.29 元/立方米，环比下降 20.87%，同比上涨 48.3%。受管束市场跌势影响，8 月 40L 瓶装氦气价格为 892.19 元/瓶，环比下降 24.11%，同比上涨 45.41%。	2026 年全球氦气供应接连遭受较大冲击：卡塔尔氦气产能受损、俄罗斯氦气出口管制、美国氦气供应减量	美国和卡塔尔是全球主要的氦气供应国	广钢气体、金宏气体、华特气体、九丰能源	15%+
靶材	26Q1 电子靶材企业已普遍启动提价，其中常规靶材价格涨幅达 20%，特殊小金属类靶材涨幅达 60%-70%。	AI 算力需求高增、原材料价格波动与地缘政治共振推动靶材价格上涨	日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯	江丰电子、有研新材、欧莱新材、阿石创、隆华科技	江丰电子全球市占率 25%+
电子级氢氟酸	2026 年 9 月 30 日我国 EL/UP/UPS/UPSS/UPSSS 级电子级氢氟酸价格分别为 7,730/7,880/8,900/10,050/11,500 元/吨，较年初分别 +22.02%/18.76%/18.67%/2.55%/4.55%。	原材料成本大幅上涨，G5 级电子级氢氟酸供需紧张	Stella Chemifa、森田化学、大金工业、关东化学、秀博瑞殷、霍尼韦尔、索尔维等	多氟多、中巨芯、滨化股份等	通用品类湿电子化学品（如电子级硫酸、双氧水、氢氟酸）国产化率 50%-80%，高端 G5 级国产化率 25%-30%
环氧塑封料	1、2026.4 韩国锦湖石化和日本三菱化学对环氧树脂模塑料等工程塑料进行调价，涨价幅度 5%-20%。 2、住友电木宣布上调用于半导体器件的封装用 EMC 价格。此次涨价范围覆盖住友电木所有等级的封装用环氧树脂模塑料，涨幅 10%-20%，自 2026 年 6 月 1 日起发货执行新价格。住友电木在全球半导体环氧模塑料领域占据约 40%市场份额。	受霍尔木兹海峡封锁影响，甲醇、二甲苯及相关溶剂供应紧张，相关产品价格自 3 月以来至少上涨 40%，这些溶剂均为生产各类特殊树脂的必需原料。此外包装材料、能源和运输成本持续攀升。	住友电木、力森诺科等	华海诚科、飞凯材料、中科科化等	30%

资料来源：证券时报网，爱集微，深圳市电子商会，上海证券报，电子工程世界，气体圈子，东方财富网，买化塑研究院，产业在线，氟化工产业圈，USGS，华尔街见闻，卓创资讯，九丰能源 2025 年年报，日本富士经济，江丰电子《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，百川盈孚，江苏化工网，多氟多投资者关系活动记录，半导体前沿，科创板日报，芯语，中科科化审核问询函回复，中银证券

下载日志已记录，仅供内部参考

我国电子材料国产替代持续推进。根据雅克科技 2025 年年报，半导体行业景气度上行，但行业内部分化态势明显，半导体材料行业作为半导体行业的上游环节，整体处于稳步发展、产业升级加速的关键发展阶段。近年来，依托国家政策支持和市场需求红利，我国半导体材料行业进入快速发展阶段，国产替代进程持续推进。国内材料企业产品技术水平和研发能力不断增强，从单一产品突破向产业链配套完善逐步过渡，整体产业竞争力稳步提升。随着全球半导体供应链本土化、多元化布局趋势加深，我国半导体材料行业有望迎来技术突破和市场扩容的双重发展机遇。此外，本轮下游高景气，叠加海外龙头扩产速度较慢、受到原材料供应波动等影响，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。

图表 7. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	业务进展
雅克科技	半导体前驱体材料	26H1 韩国先科实现营收 8.62 亿元、净利润 1.78 亿元（同比+8.74%），江苏先科实现营收 7.47 亿元（同比+34.69%）、净利润 0.77 亿元（同比+351.03%）。26H1 公司加大研发投入，已构建中国和韩国双研发部门，不断开发芯片先进制程薄膜沉积工艺和人工智能先进封装复杂芯片组所需的各种前驱体材料。国产化项目江苏先科 26H1 营收和营业利润同比大幅增长，目前已达到 high-k 前驱体有机配体完全自产能力，并向韩国子公司出口粗品前驱体。为满足海外晶圆厂对前驱体材料不断升级和扩大的需求，韩国子公司 UP CHEM 新建第三工厂，预计于 2026 年底全面投产，同时在 26H1 新购土地并开始第四工厂的规划。
	电子特气	国家电网及特高压直流工程的大规模建设将促进成都科美特六氟化硫绝缘气体的市场需求。同时，公司内蒙古科美特项目建设推进顺利，预计将于 26Q3 开始投入生产。12,000 吨六氟化硫及 3,000 吨四氟化碳电子特气新产能的建设，不仅能满足增量的市场需求扩大销售规模，而且充分利用内蒙古绿电资源禀赋，降低生产电费成本。
	湿电子化学品	公司拥有半导体和显示光刻胶的配套显影液、稀释剂和剥离液等湿电子化学品的南通和广州工厂，26H1 湿电子化学品客户端导入持续推进，已进入国内多家主流半导体晶圆厂及显示面板厂商供应链。依托半导体材料平台化布局，光刻胶配套试剂产品线生产和销售同比大幅增长。
安集科技	CMP 抛光液	26H1 公司抛光液收入 12.04 亿元（同比+29.47%），毛利率 55.58%（同比-2.52pct）。近三年公司化学机械抛光液全球市占率分别约 8%、11%、13%。26H1 公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程持续上量，多款产品在多个新客户端作为首选供应商实现量产销售，使用国产研磨颗粒的产品持续量产销售；在介电材料抛光液方面，部分用于先进制程的氮化硅抛光液已通过客户验证、实现销售，使用国产研磨颗粒的氧化物抛光液销售逐步上量；钨抛光液在存储芯片和逻辑芯片领域的成熟和先进工艺市场份额持续上升；基于氧化铈磨料的抛光液产品市占率持续扩大，使用自研自产的国产氧化铈磨料的多个抛光液产品在多个客户端量产应用，同时先进节点客制化产品在客户端验证顺利；金属栅极抛光液在数家客户实现量产并持续上量，应用于技术迭代的先进制程产品开发及验证顺利；在衬底抛光液方面，公司紧跟国内大硅片企业发展定制化开发抛光液产品；公司持续加强先进封装用抛光液布局，用于 TSV、TGV 抛光液、混合键合抛光液和聚合物抛光液进展顺利，同时积极跟海外客户合作，产品验证进展顺利。
	功能性湿电子化学品	26H1 公司功能性湿电子化学品收入 3.13 亿元（同比+51.03%），毛利率 55.99%（同比+6.98pct）。公司已覆盖刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列，广泛应用于逻辑电路、3DNAND、DRAM、CIS 等特色工艺及异质封装等领域。在刻蚀后清洗液方面，先进制程刻蚀后清洗液研发及产业化进展顺利、快速上量，并持续扩大海外市场；在抛光后清洗液方面，先进制程碱性铜抛光后清洗液进展顺利、快速上量，持续增加市场份额；刻蚀液验证进展顺利，实现小量量产。26H1 公司持续加强在 3D IC 领域布局，多款产品在国内客户成为首选，支持国内异质集成技术发展。
鼎龙股份	CMP 抛光垫	26H1 公司抛光垫收入 7.45 亿元（同比+56.83%），其中 26Q2 收入 3.69 亿元（同比+44.48%），6 月单月销量首次突破 5 万片。抛光硬垫方面，先进制程用抛光垫出货数量及占比持续增长，国内市场份额稳定提升，本土外资晶圆厂客户及海外市场开拓有序推进，已与多家外资晶圆厂客户达成初步合作意向并推进产品测试与导入。抛光软垫方面，潜江工厂软垫及缓冲垫持续稳定供应，积极拓展大硅片、第三代半导体 SiC、先进封装 TSV 等新领域市场，成功切入并获取订单。此外，公司开展下一代玻璃基板 CMP 抛光垫的研发和市场推广，成功获得板级封装领域重要客户订单。产能方面，公司建设武汉年产 40 万片大硅片抛光垫产能、潜江年产 30 万片玻璃基板 CMP 抛光垫及大尺寸抛光垫产能。

资料来源：各公司 2026 年中报，安集科技 2025 年年报，中银证券

下载日志已记录，仅供内部参考

续 图表 7. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	业务进展
	CMP 抛光液、清洗液	26H1 公司抛光液、清洗液收入 1.93 亿元（同比+63.02%），其中 26Q2 收入 1.08 亿元（同比+70.69%，环比+27.33%），6 月单月销售额突破 4,000 万元。抛光液方面，26H1 公司大硅片精抛液产品实现批量交付，氧化铈抛光液产品在国内龙头存储芯片客户量产线导入成功、获得首张订单，TSV 抛光液通过国内先进封装龙头客户验证，铜阻挡层抛光液再获新客户批量订单，SiC 衬底抛光液取得国内客户批量采购订单；同时公司实现四大体系研磨粒子自研自产。清洗液方面，铜 CMP 后清洗液产品在国内多家客户实现增量销售，其他制程清洗液持续拓展市场，另有多款新产品在客户端持续开展验证。
	半导体光刻胶	公司已有 8 款高端晶圆光刻胶（浸没式 ArF 与 KrF 光刻胶各 4 款）取得多家国内主流晶圆厂客户批量订单，26H1 合计获取约 1,000 加仑订单。产能方面，公司潜江一期年产 30 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶产线稳定运行，二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线已于 26Q1 末建成投产。
江丰电子	溅射靶材	26H1 年公司高纯金属溅射靶材收入 16.71 亿元（同比+26.08%），毛利率 31.77%（同比-1.49pct）。公司在全球超高纯金属溅射靶材市占率不断提升，积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的建设投产，黄湖靶材智能工厂所涉厂房已按计划建成，同时韩国江丰靶材工厂主体工程已投入建设。
沪硅产业	硅片	300mm 方面，截至 26 年中报，公司上海、太原两地 300mm 半导体硅片合计产能达 100 万片/月，子公司上海新昇销量同比增幅超过 90%，至 2026 年底预计 300mm 半导体硅片产能将达到 120 万片/月。26H1 国内硅片市场逐步企稳回暖，预计相关红利将在 26H2 逐步释放。200mm 方面，公司 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月，200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超 6.5 万片/月；Okmetic 在芬兰万塔的 200mm 半导体特色硅片扩产项目一期建设已基本完成，预计 26H2 产能将逐步释放。公司 300mmSOI 硅片正处于产品验证送样及小批量量产阶段，26H1 子公司新傲芯翼已建成产能约 30 万片/年的 300mm SOI 硅片试验线。26H1 子公司新硅聚合的单晶压电薄膜衬底材料产线完成既定建设计划，应用于滤波器的衬底实现量产并持续出货；完成光学级铌酸锂、钽酸锂薄膜衬底的研发并转入量产阶段；完成 200mm 单晶压电薄膜衬底的研发并实现批量交付，同时启动高频滤波器、高速光通信芯片新型衬底预研。
西安奕材	硅片	26H1 公司产线持续处于满稼动状态，在手订单充足。26H1 公司累计实现销量约 500 万片（同比+29.75%），实现营收 15.89 亿元（同比+22.00%），其中抛光片销售 5.21 亿元（同比+16.27%），外延片销售 4.88 亿元（同比+53.05%），测试片销售 5.77 亿元（同比+8.61%）。截至 26 年中报，公司已布局西安和武汉两个基地，其中西安基地第一工厂不断提升效能、第二工厂正在产能爬坡，位于武汉基地的第三工厂正处于厂房建设阶段，截至 26H1 公司产能合计达到 100 万片/月以上。26H1 公司出货量全球市占率约 7.7%，位居 12 英寸硅片领域国内第一、全球第六。公司预计 2026 年 12 月第二工厂 50 万片/月产能达产，届时将具备约 120 万片/月产能，有望位居国内第一、全球前五。第三工厂预计 2026 年 10 月实现首批设备搬入，27H1 实现首批产能投产，2030 年前实现达产，达产后总产能将提升至约 180 万片/月以上。
上海新阳	清洗液、刻蚀液、研磨液等系列产品	26H1 公司集成电路材料实现营收 9.82 亿元（同比+43.63%），毛利率 46.79%（同比+0.89pct）。公司干法刻蚀后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖，26H1 干法刻蚀后清洗液产品销售规模不断扩大，销售额同比增长近 40%。公司原创开发的用于芯片制造的蚀刻液产品已实现四代技术产品的开发及迭代升级，26H1 蚀刻液销售额同比增长超 70%。公司化学机械研磨液产品持续优化，STI slurry、Poly slurry、W slurry、Oxide slurry 等系列产品在头部客户端测试验证顺利，其中先进制程 STI slurry、Poly slurry 产品已进入国内主流晶圆公司产线，26H1 研磨液产品销售额同比增长 140%。
	半导体光刻胶	公司已建成包括 I 线、KrF、ArF 干法、ArF 浸没式各类高端光刻胶完整的研发合成、配制生产、质量管控、分析测试平台，部分品类产品已实现产业化导入。26H1 公司形成批量稳定供货的光刻胶数量快速提升，整体销售规模同比增长 27%。
中船特气	电子特气	六氟化钨作为核心增长极，26H1 营收同比增长近 3 倍。境外高纯钨粉供给受限，叠加下游 AI 先进制程与高堆叠存储需求持续扩容，全球六氟化钨市场呈紧平衡态势。公司依托完整的上游原料自主配套优势，实现量价齐升，盈利质量显著改善。借此窗口期，公司六氟化钨产品境内实现新增产线全覆盖，境外获头部客户送样测试与产线全流程验证机会，长协签订工作有序推进，同时在美光、铠侠、英特尔、海力士等国际主流存储及逻辑芯片客户中市占率稳步提升。26H1 公司三氟化氮产品营收同比增长约 13%，境内方面新增多家大型面板企业的准入与批量供货，境外方面依托六氟化钨高景气带来的供应链替代窗口期，进一步提升海外头部客户供应量，并有序落地多家长期供货协议。三氟甲磺酸系列产品持续放量，26H1 实现营收约 2.12 亿元，同比增长超 40%。

资料来源：各公司 2026 年中报，安集科技 2025 年年报，中银证券

下载日志已记录，仅供内部参考

续 图表 7. 国内部分企业部分晶圆制造材料业务进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	业务进展
广钢气体	电子大宗气体	26H1 公司电子大宗气体业务实现营收 10.56 亿元(同比+30.18%),毛利率 38.31%(同比+8.22pct),收入占比进一步提升至 79.20%;通用工业气体业务营收 2.17 亿元(同比-14.19%),毛利率 15.41%（同比+4.16pct）。公司 2011 年通过与外资合营合作进入电子大宗气体行业，2018 年中标国内半导体显示行业客户的现场制气项目，首次实现了内资气体公司在半导体显示行业供应超高纯电子大宗气体的突破。电子大宗气体现场制气项目供气周期通常长达 15 年，具备长周期、高稳定性的业务特征。公司电子大宗气体业务深度服务国内半导体与集成电路龙头客户群，截至 26H1 已累计获得 11 座 12 英寸晶圆厂客户认可。
清溢光电	掩模版	26H1 公司平板显示掩膜版产品实现营收 5.28 亿元（同比+7.42%），半导体芯片掩膜版业务营收约 1.01 亿元（同比+0.95%）。公司 55nm Binary 工艺节点通过客户验证，目前正稳步推进 130nm－40nm 工艺节点 PSM 与 OPC 工艺掩膜版研发，并启动 28nm 节点掩膜版工艺开发规划，持续向高端制程突破。此外，公司已掌握电子束光刻、干法蚀刻等中高端掩膜版核心关键工艺，为后续产品升级与技术迭代筑牢基础。产能布局方面，佛山清溢微生产基地将在 2026 年底实现 PSM 技术掩膜版量产，助力公司抢占高端掩膜版市场份额。
路维光电	掩模版	公司在显示领域已实现全世代覆盖（G2.5-G11）、全显示技术覆盖（LCD、AMOLED、LTPS、LTPO、Mini-LED、Micro-LED、硅基 OLED、FMM 用掩膜版等）；在半导体领域则全面布局先进封装及成熟制程用掩膜版市场，广泛服务于晶圆制造企业、IC 设计公司及封装测试厂商；通过投资路芯半导体将半导体掩膜版制程拓展至 14nm。
彤程新材	半导体光刻胶	26H1 公司电子化学品业务实现营收 6.93 亿元（同比+56.89%），占总营收比重提升至 32.44%；实现利润 1.06 亿元（同比+近 180%）；其中光刻胶及配套试剂实现营收 5.2 亿元。26H1 公司半导体光刻胶及配套试剂实现营收 2.86 亿元，同比增长近 50%；ArF 及 BARC 产品同比增幅接近 300%，多款产品包含 3 款浸没式光刻胶，在客户端实现稳定量产供应；KrF 光刻胶在售产品超过 60 款，国内本土市场占有率已超过 10%；G/I 线光刻胶在售产品超过 100 款，国内本土市场占有率超过 35%。多款光刻胶产品搭载公司自研树脂。公司已实现对国内绝大部分 12 英寸产线的稳定供货，12 英寸产品收入占比突破 50%。26H1 公司已有超 20 款新产品得到客户正式订单。
	CMP 抛光垫	26H1 公司抛光垫业务销售总额超 2,000 万元。先进抛光垫硬垫产品系列自 2025 年末起陆续送样头部客户开展验证，目前该高端产品系列已完成客户验证，正逐步导入量产。公司抛光垫软垫生产线已建成落地，截至 26 年中报，软垫样品已送样国内多家主流 12 英寸晶圆厂，进入客户验证导入环节。伴随硬垫产品量产导入稳步推进、软垫客户端验证持续深化，公司预计下半年抛光垫业务将进入快速上量阶段。
兴福电子	通用湿电子化学品	26H1 公司集成电路领域销售收入占主营业务收入比例达 87.82%，集成电路领域销售收入中通用湿电子化学品销量 8.90 万吨（同比+24.65%），收入 6.09 亿元（同比+34.13%）。 电子级硫酸小粒径颗粒物指标进一步优化，顺利通过新加坡镁光、鹏芯微等高端客户验证，已启动批量供货，多家国内头部晶圆厂测试稳步推进；电子级双氧水金属离子含量、阴离子含量实现稳定控制，产品纯度指标持续优化，顺利通过鹏芯微等高端客户验证，并实现稳定销量；电子级磷酸持续开展纯化工艺升级，核心品质稳定性大幅提升。同时，电子级氨水、电子级氨气、电子级异丙醇等产品及配套化学品纯化技术持续突破，客户验证与批量供货同步落地。
	功能湿电子化学品	26H1 公司功能湿电子化学品销量 0.72 万吨（同比+75.61%），收入 1.46 亿元（同比+56.73%）。高选择比磷酸、先进金属蚀刻液积极推进国内头部存储厂商测试验证，计划年内供应；硅锗系列高性能蚀刻液整体性能达到行业先进水平，多款新品实现批量销售。多款 BOE 蚀刻液产品完成客户端验证与供应，同时稳步推进高端电子清洗剂配方自主开发及头部客户送样验证，先进制程专用清洗剂验证效果符合预期。玻璃基化镀镍金药水已实现客户稳定供货，硅基化镀镍钯金药水完成工艺优化并实现小批量销售。

资料来源：各公司 2026 年中报，安集科技 2025 年年报，中银证券

下载日志已记录，仅供内部参考

图表 8. 国内部分企业先进封装材料项目进展（截至 2026 年中报）

企业	产品名称	技术进展
鼎龙股份	半导体封装 PI、临时键合胶	26H1 公司半导体先进封装材料产品处于销售起量阶段，新产品的验证导入及市场推广持续推进。半导体封装 PI 方面，公司已布局 8 款产品，目前共有 3 款产品取得多家客户的订单，在售型号数量及覆盖客户数量进一步增加，推动订单增长持续加速。临时键合胶方面，公司在已有客户持续稳定规模出货中。
德邦科技	芯片级底部填充胶（Underfill）、Lid 框粘接材料（AD 胶）、芯片级导热界面材料（TIM1）、固晶胶膜（DAF 膜）等	26H1 公司集成电路封装材料实现营收 1.79 亿元（同比+58.45%），毛利率 38.91%（同比-3.98pct）。公司晶圆 UV 膜、固晶胶、TIM1.5/TIM2 高端导热界面材料等产品已在国内主流封测厂商实现稳定批量供货，成熟品类国产化配套优势持续夯实；DAF/CDAF 膜、底部填充胶（Underfill）、Lid 框胶已实现小批量交付，芯片级导热材料（TIM1）已顺利通过国内某重要封测客户全套可靠性验证，芯片级先进封装材料商业化落地进程持续提速。
飞凯材料	EMC 环氧塑封料、键合胶、先进封装光刻胶等	26H1 公司半导体材料实现营收 3.58 元（同比+8.17%）。面向先进封装技术前沿，公司围绕临时键合工艺推出键合胶与清洗液全配套解决方案，兼容热力、机械及激光等多种解键合方式。公司在蚀刻液、去胶液、电镀液等湿制程电子化学品领域的先期卡位，已使相关产品成为多家头部客户的标准制程材料，并成功延伸应用于 2.5D/3D 及 HBM 等高端封装场景。近年推出的 Ultra Low Alpha Microball（ULA 微球）、临时键合全套方案、先进封装光刻胶及 EMC 环氧塑封料等新品，均可适配 2.5D/3D 封装及 HBM 封装需求。公司控股子公司昆山兴凯聚焦半导体封装材料国产化与高端应用，是中高端元器件及 IC 封装所需的封装材料领域主要供货商之一。
强力新材	光敏性聚酰亚胺（PSPI）、半导体先进封装用电镀材料	公司积极研发推进新产品，例如应用于半导体先进封装领域的光敏性聚酰亚胺（PSPI）及电镀铜、镍、锡银等电镀液产品。公司的光敏性聚酰亚胺（PSPI）产品包括 350℃高温固化、250℃低温固化及 180℃超低温固化三种类型。电镀铜、镍、锡银等电镀液产品，可覆盖 RDL、Pillar、μBump、TSV、TIV、大马士革等工艺。26H1 公司高温 PSPI 产品收到某贸易商百公斤级订单，该订单的产品应用于前制程（应力缓冲层 Buffer coat），订单金额不足两百万元人民币。截至 26 年中报，该订单已交付过半。26H1 公司高温 PSPI 和低温 PSPI 产品，陆续收到国内某客户订单，订单总数量不足一百公斤，订单产品应用于先进封装领域中的 RDL 层。部分电镀液产品在客户端处于小批量产品验证阶段。
天承科技	半导体先进封装专用化学品	公司围绕集成电路、2.5D/3D 先进封装、扇出型封装、玻璃基板等领域需求积极研发，目前公司已完成大马士革电镀铜、硅通孔（TSV）电镀铜、再布线层（RDL）电镀铜、凸点（bumping）电镀铜/镍/锡银和玻璃基板通孔 TGV 金属化等工艺所需电镀液产品的研发和技术储备。
上海新阳	电镀液及添加剂	公司电镀系列材料已广泛应用于先进封装工艺制程，为客户提供良好的技术保证。公司电镀系列产品的市场影响力从传统封装、晶圆制造延伸至先进存储领域。26H1 公司电镀液及添加剂系列产品销售额同比增长超 30%。
安集科技	CMP 抛光液、清洗液	26H1 公司持续加强在先进封装用抛光液的布局，用于 TSV、TGV 抛光液、混合键合抛光液和聚合物抛光液进展顺利，在国内客户均作为首选供应商帮助客户打通技术路线，并持续为客户的新工艺开发产品，助力国内先进封装技术的发展，销售持续上量。
	电镀液及添加剂	26H1 公司集成电路大马士革电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；硅通孔电镀液及添加剂进入量产阶段，实现销售；先进封装锡银电镀液及添加剂等产品开发及验证按计划进行。
艾森股份	电镀液及添加剂	公司高纯硫酸铜基液已实现先进封装头部客户的稳定供应，另有多项前沿产品已进入商业化关键阶段：电镀锡银添加剂（包括超低 α 粒子的锡浓缩液、锡阳极）小批量稳定量产，并在多家头部客户同步验证中；电镀铜添加剂处于关键批次稳定性验证阶段；TSV 电镀铜添加剂在客户端测试验证中。
	先进封装光刻胶、PSPI	公司涵盖可应用于 GHI-line、I-line 光源的光刻胶产品，包括正性、化学放大型光刻胶及负性光刻胶，不同产品膜厚兼容 7-300μm，在 Bumping、RDL、TSV、fine pitch RDL、μBumping、μPad、Mega-Bumping 等先进封装核心工艺环节，正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。同时公司加速推进用于 Bumping、WLCSP、2.5D/3D 封装 PSPI 的验证与量产，产品包括高温固化、低温固化、超低温固化系列，其中低温 PSPI 在客户端小量产中，具备低应力、高可靠性及高分辨率的 PSPI 产品在客户端验证中。公司目标成为国内先进封装光刻胶和 PSPI 领域的主力供应商。

资料来源：各公司 2026 年中报，中银证券

为复盘 2026 年上半年电子材料行业整体业绩表现，我们选取申万三级子行业 SW 半导体材料（30 家标的）、SW 电子化学品（37 家标的）以及彤程新材、联瑞新材合计 69 家标的，组成电子材料行业标的库。我们对该标的库内的区间涨跌幅、总市值、营业总收入、归母净利润、毛利率、净利率、研发费用率等指标进行了统计分析。注：因部分材料公司包含其他业务（如传统化工产业占比较高），部分指标分析可能有所偏差。

下载日志已记录，仅供内部参考

图表 9. 本报告电子材料行业 69 家标的库包含标的（截至 2026.9.30）

申万三级子行业	包含标的
半导体材料	康强电子、雅克科技、中晶科技、江丰电子、阿石创、富乐德、珂玛科技、新恒汇、有研新材、先导基电、立昂微、沪硅产业、清溢光电、中船特气、神工股份、天岳先进、路维光电、有研硅、欧莱新材、华海诚科、上海合晶、和林微纳、艾森股份、龙图光罩、恒坤新材、西安奕材、臻宝科技、创达新材、凯德石英、康美特
电子化学品	西陇科学、万润股份、光华科技、鼎龙股份、上海新阳、国瓷材料、南大光电、飞凯材料、强力新材、濮阳惠成、广信材料、容大感光、晶瑞电材、中石科技、唯特偶、思泉新材、同宇新材、C 鸿富诚、天通股份、宏昌电子、江化微、海星股份、格林达、安集科技、德邦科技、金宏气体、莱特光电、华特气体、三孚新科、菲沃泰、兴福电子、广钢气体、中巨芯、瑞联新材、天承科技、莱尔科技、凯华材料
其他	彤程新材、联瑞新材

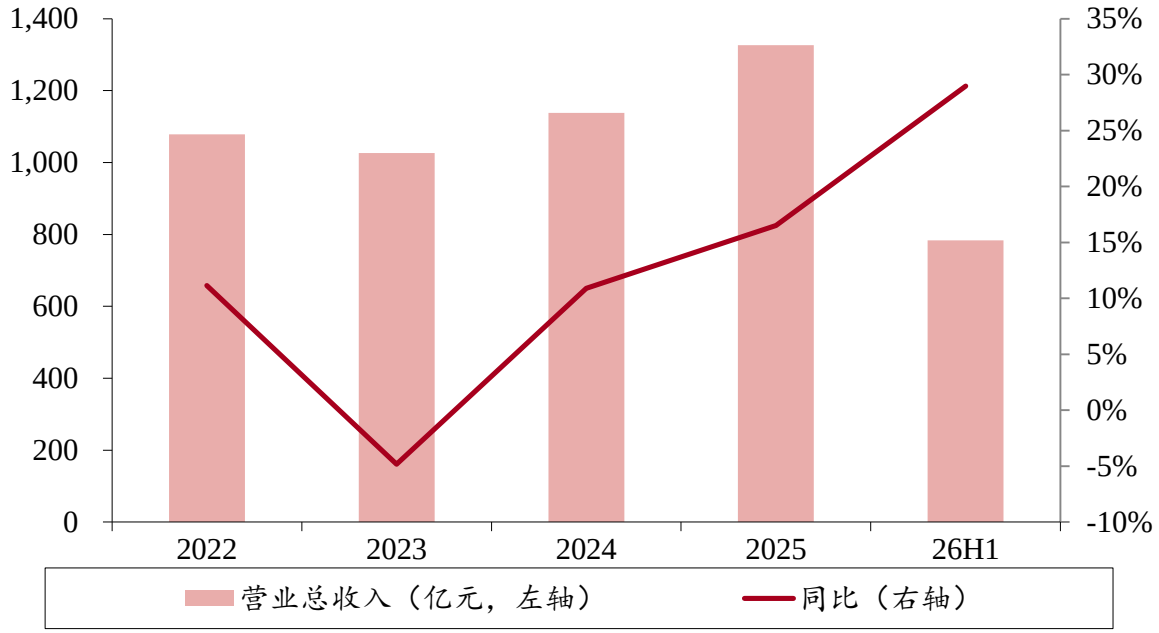
资料来源：万得，中银证券

营业总收入：规模稳健增长，量价共振增厚收入

根据我们建立的电子材料行业 69 家标的库，2026 年上半年营业总收入合计 783.21 亿元（同比+28.97%），行业整体规模持续扩容；单季度看，26Q2 营收合计 419.71 亿元，同比+31.99%、环比+16.86%，环比增速较 26Q1（营收合计 359.15 亿元、环比+0.55%）进一步抬升。数据变化的主要原因为：一是 AI 算力与先进存储需求扩张带动下游晶圆厂产能释放，靶材、CMP 材料、前驱体、电子特气等核心材料需求同步上行；二是国产替代加速，头部企业产品在主流晶圆厂、存储厂批量供货并持续提升份额；三是六氟化钨、硅片、氦气等部分材料进入涨价通道，量价共振增厚收入。

部分重点标的变化：从 26H1 营业收入同比增速来看，根据各公司 2026 年中报，26H1 中船特气营收同比增长 83.13%，主要系六氟化钨量价齐升（营收同比增长近 3 倍）及三氟甲磺酸系列持续放量；有研新材营收同比增长 50.35%，薄膜、铂族产品销量增加且材料价格上涨（薄膜/铂族产品收入分别+63%/+65%）；沪硅产业营收同比增长 36.51%，300mm 硅片销售收入增加约 6 亿元；中巨芯营收同比+40.98%，电子特种气体及前驱体收入增长 136.8%；安集科技（+33.72%）、江丰电子（+30.68%）、彤程新材（+29.10%）等亦保持较快增长。部分中小市值标的 26H1 营收同比有所下滑（菲沃泰-21.63%、凯德石英-12.44%、和林微纳-6.52%），对整体影响有限。

图表 10. 2022-26H1 电子材料行业营业总收入及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

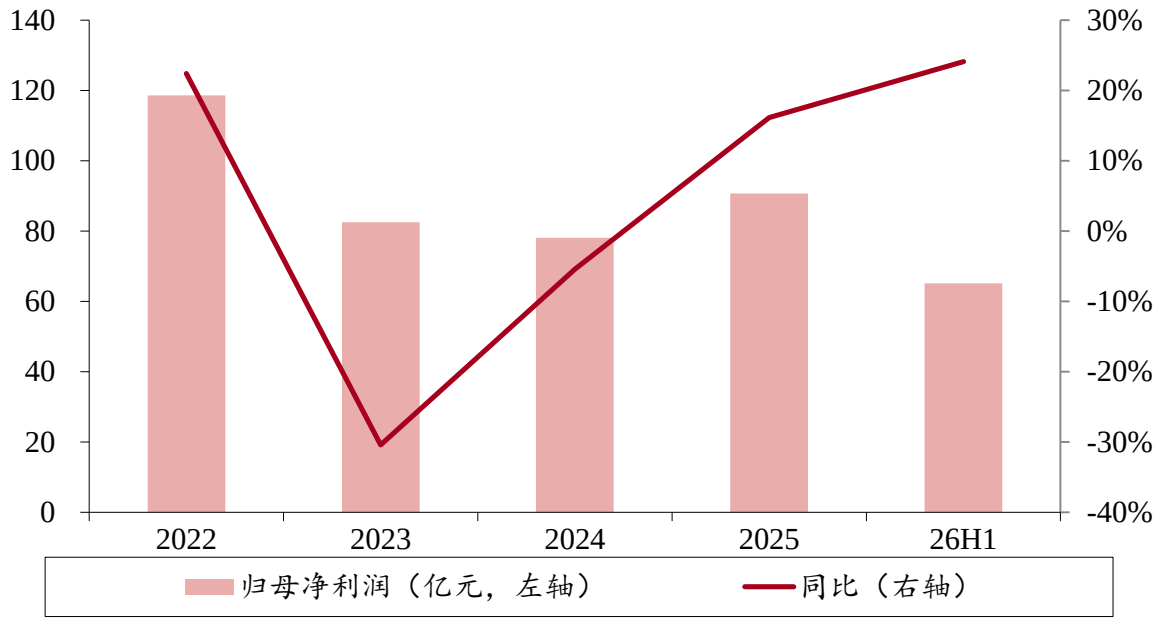
下载日志已记录，仅供内部参考

归母净利润：26Q2 盈利改善提速，利润弹性集中于 AI 链及国产替代龙头

2026 年上半年 69 家标的归母净利润合计 65.09 亿元（同比+24.11%），增速较营收低 4.86pct，其中 62 家盈利、7 家亏损（亏损合计 17.10 亿元，沪硅产业、西安奕材、天通股份三家合计占近九成）。利润增速较营收低的主要原因为：一是硅片等重资产环节仍处于亏损状态（产品价格低位与折旧高企），二是部分公司毛利率承压及研发、财务费用增长，而 AI 链材料龙头利润弹性显著、部分公司减亏扭亏对整体形成支撑。单季度看，26Q2 归母净利润 39.26 亿元，同比+43.98%、环比+52.00%，盈利改善斜率快于收入。

部分重点标的变化：从 26H1 归母净利润同比增速来看，根据各公司 2026 年中报，利润弹性集中于 AI 链及国产替代龙头。26H1 广钢气体归母净利润同比增长 117.73%，主要系电子大宗气体收入同比+30.18%、毛利率+8.22pct；江丰电子归母净利润同比增长 113.61%，其中靶材/零部件收入分别增长 26.08%/40.59%，规模效应显现；中船特气+95.63%、鼎龙股份+70.21%（抛光垫放量、产品结构优化）、安集科技+41.56%、有研新材+40.89%；立昂微扭亏为盈（归母净利润 0.84 亿元）。亏损的企业主要为：西安奕材同比减亏 14.98%，沪硅产业亏损 9.65 亿元（收入高增但价格修复尚未传导），天通股份由盈转亏（光伏业务拖累、已实施全面收缩与战略转型）。

图表 11. 2022-26H1 电子材料行业归母净利润及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

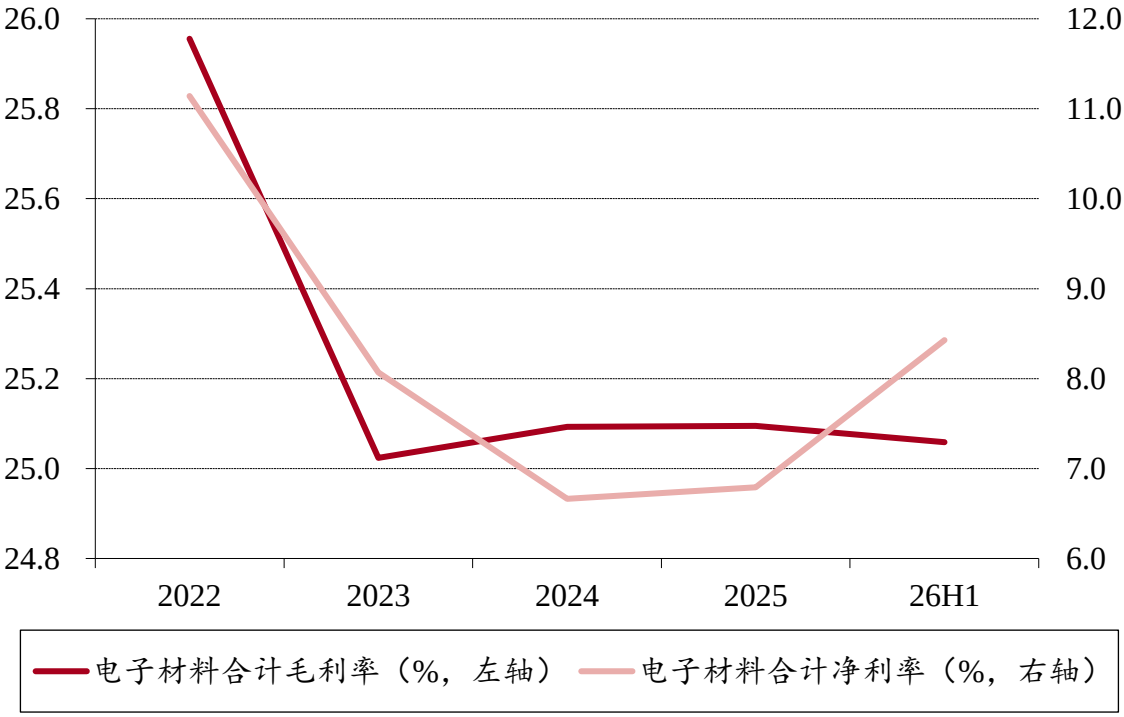
毛利率与净利率：结构性分化显著

2026 年上半年 69 家标的整体毛利率/净利率分别为 25.06%/8.43%，同比分别-0.70pct/-0.24pct。毛利率小幅承压的主要原因为：部分公司低毛利业务（贵金属、贸易类等）占比提升、个别品类价格竞争以及原材料成本波动；净利率降幅小于毛利率，反映规模效应与费用结构优化的对冲。

部分重点标的变化：26H1 毛利率居前的包括莱特光电（71.24%）、C 鸿富诚（68.15%）、鼎龙股份（58.83%）、安集科技（55.63%）、恒坤新材（52.46%）等；26H1 毛利率同比改善显著的有欧莱新材（+13.23pct）、恒坤新材（+10.81pct）、鼎龙股份（+9.60pct）、阿石创（+9.27pct）、广钢气体（+9.01pct）及沪硅产业（+4.76pct，硅片价格逐步企稳），其中广钢气体电子大宗气体业务毛利率 38.31%（同比+8.22pct）；毛利率同比下滑较大的包括菲沃泰（-24.33pct）、龙图光罩（-19.72pct）、新恒汇（-12.83pct）、富乐德（-12.82pct）、珂玛科技（-9.83pct）等。此外，有研新材毛利率（7.42%）受贵金属及贸易类业务摊薄，表观指标与纯半导体材料公司不完全可比。

下载日志已记录，仅供内部参考

图表 12. 2022-26H1 电子材料行业毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

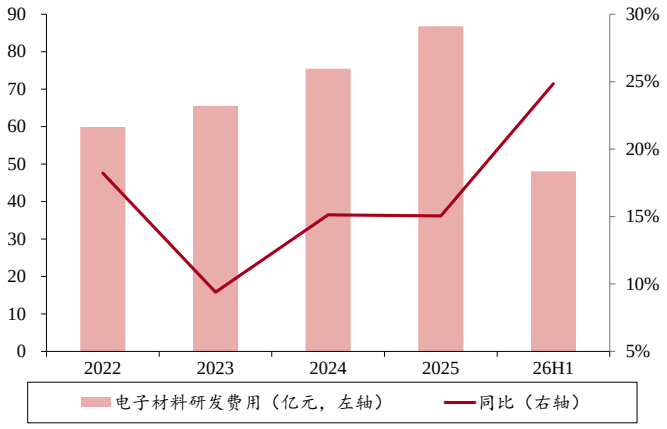
研发费用：高端材料品类持续加大开发与验证投入

2026 年上半年 69 家标的研发费用合计 48.05 亿元（同比+24.85%），研发费用率 6.14%（同比-0.20pct）；单季度看，26Q2 研发费用合计 26.18 亿元（同比+29.90%）。数据变化的主要原因为：头部企业围绕光刻胶、前驱体、CMP 材料等高端品类加大开发与验证投入，研发人员扩张与股份支付增加推升费用规模；研发费用率小幅回落，主要系收入增速快于研发费用增速。

部分重点标的变化：近三年电子材料行业整体研发费用率均维持在 6%以上，鼎龙股份、安集科技等龙头企业的研发费用率超过 15%，持续投入为高端材料国产化突破夯实技术基础。26H1 研发费用绝对值靠前的包括鼎龙股份（2.96 亿元，研发费用率 15.39%）、沪硅产业（2.59 亿元，研发费用率 11.17%）、安集科技（2.46 亿元，研发费用率 16.13%）、先导基电（2.29 亿元，研发费用率 20.01%）、万润股份（2.18 亿元，研发费用率 10.98%）、雅克科技（1.87 亿元，研发费用率 4.15%）、国瓷材料（1.65 亿元，研发费用率 6.57%）、上海新阳（1.63 亿元，研发费用率 13.62%）、江丰电子（1.59 亿元，研发费用率 5.81%）等；研发费用率居前的有菲沃泰（24.90%）、先导基电（20.01%）、恒坤新材（17.90%）、安集科技（16.13%）、鼎龙股份（15.39%）等。根据鼎龙股份 2026 年中报，公司着力攻克高端 KrF/ArF 光刻胶自主化难关，已建成全流程高端晶圆光刻胶量产线；根据雅克科技 2026 年中报，公司已构建中国和韩国双研发部门，跟踪半导体前驱体世界前沿技术。

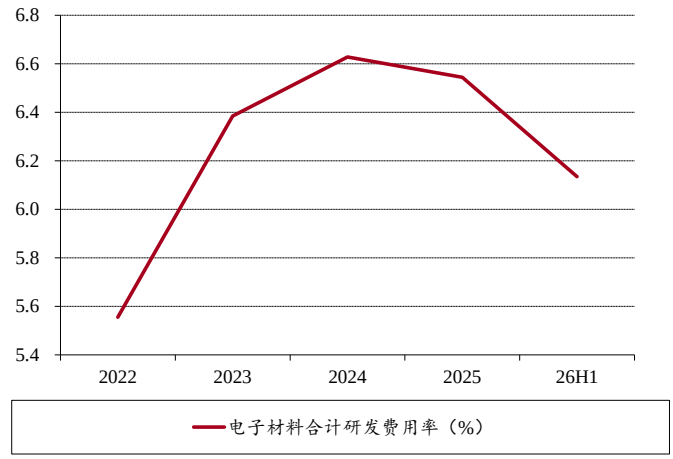
下载日志已记录，仅供内部参考

图表 13. 2022-26H1 电子材料行业研发费用及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

图表 14. 2022-26H1 电子材料行业研发费用率



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

资本开支：扩张节奏平稳、投资强度企稳，龙头加码先进产能与新品布局

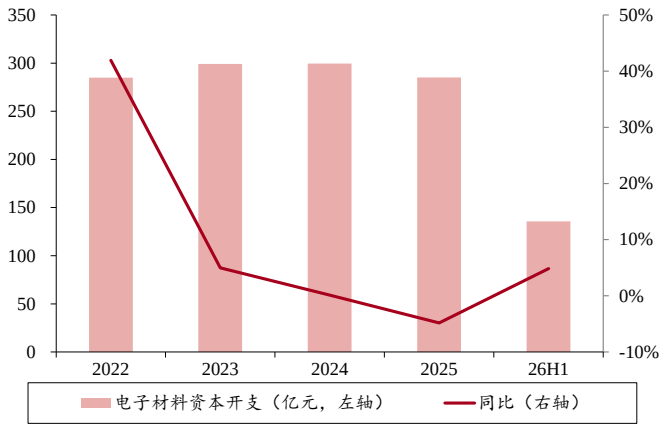
2026 年上半年 69 家标的资本开支合计 135.66 亿元(同比+4.84%)，26H1 末固定资产净额合计 1,219.70 亿元（同比+17.84%），资本开支占期末固定资产净额的比重为 11.12%，较上年同期的 12.50%下降 1.38pct；分季度看，26Q1 资本开支 60.08 亿元(同比-10.35%)、26Q2 回升至 75.57 亿元(同比+21.16%、环比+25.78%）。从历史数据看，电子材料行业资本开支在 2021-2022 年集中扩张（2022 年 284.90 亿元、同比+41.92%），2023 年以来进入 285-300 亿元平台期，2025 年小幅回落至 285.05 亿元（同比-4.81%），26H1 恢复正增长；资本开支占期末固定资产净额的比重由 2021-2022 年的 44.78%/46.50%连续回落至 2023-2025 年的 39.44%/30.99%/24.03%，26H1 为 11.12%；若以滚动 12 个月口径（25H2+26H1）衡量，该比例为 23.88%，与 2025 年基本持平，投资强度呈现企稳迹象。

数据变化的主要原因为：一是前期集中开工的大型项目（硅片、特气基地等）陆续建设完成、转入产能爬坡与客户验证阶段，固定资产净额由 2021 年末的 448.31 亿元扩大至 26H1 末的 1,219.70 亿元，存量摊薄主导了 2023-2024 年该比重的回落，此外 2025 年起部分公司项目收尾或节奏调整，投入强度进一步下移；二是龙头企业继续围绕先进产能与新产品线加大投入，部分公司资本开支高增（国瓷材料+213.06%、上海新阳+263.94%、彤程新材+138.14%），投资持续向龙头与先进环节集中（2025 年资本开支 CR10、CR20 分别达 56.62%、75.77%，沪硅产业占全行业的 17.22%）；三是行业整体从大规模扩产阶段转向“产能爬坡+结构升级”阶段，资本开支占营收比重由 25H1 的 21.31%降至 26H1 的 17.32%。

部分重点标的变化：26H1 沪硅产业（资本开支 21.48 亿元，同比+10.64%）与西安奕材（资本开支 11.58 亿元，同比+13.58%）继续扩产，沪硅产业 300mm 硅片产能至 2026 年底预计达 120 万片/月，西安奕材预计 2026 年 12 月第二工厂 50 万片/月产能达产、第三工厂 2026 年 10 月首批设备搬入；广钢气体（资本开支 7.32 亿元，同比+11.48%）持续推进电子大宗气体现场制气项目投建；江丰电子（资本开支 7.14 亿元，同比+3.64%）加码靶材与精密零部件产能。部分公司因项目阶段性完成或节奏调整，资本开支明显回落。例如中船特气（资本开支 1.29 亿元，同比-70.85%，上海电子特气及先进材料项目建筑工程已全部建设完成）、雅克科技（资本开支 2.35 亿元，同比-49.11%）、鼎龙股份（资本开支 2.91 亿元，同比-38.54%）、立昂微（资本开支 3.19 亿元，同比-36.34%）；彤程新材（资本开支 2.58 亿元，同比+138.14%）推进常州 CMP 抛光垫项目建设，预计下半年进入快速上量阶段。

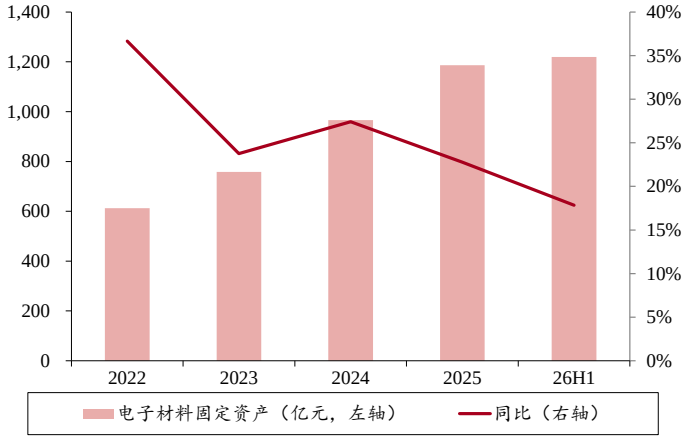
下载日志已记录，仅供内部参考

图表 15. 2022-26H1 电子材料行业资本开支及同比



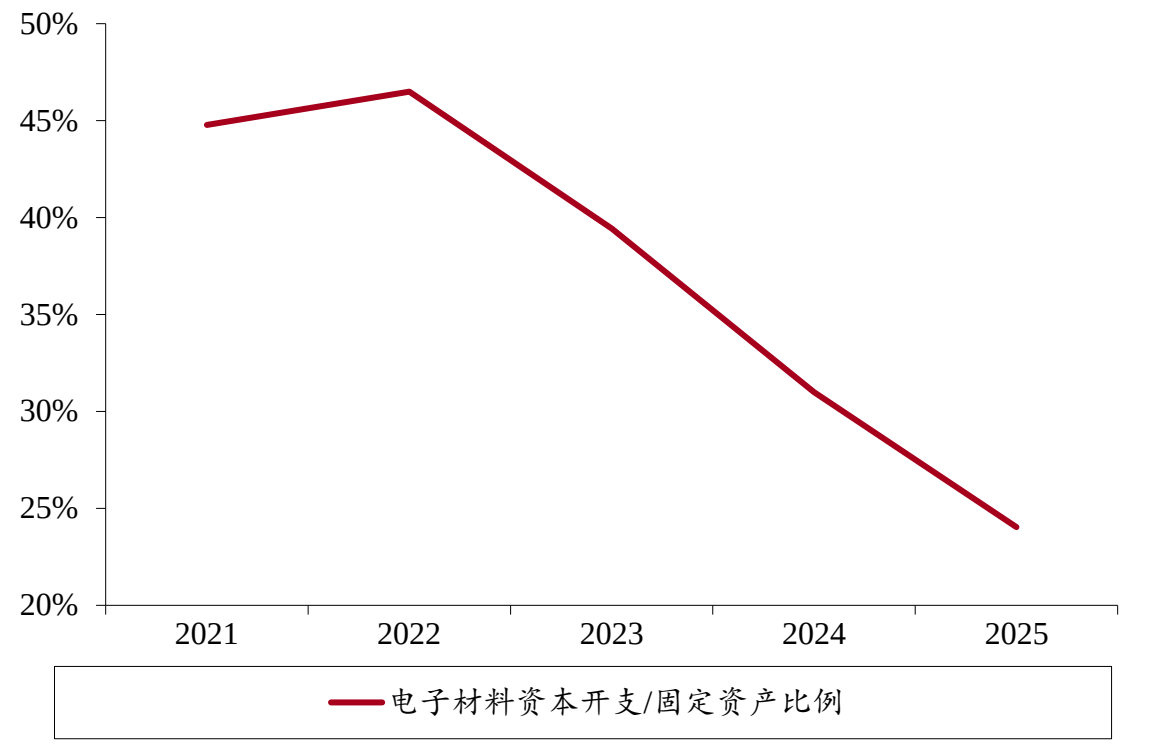
资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

图表 16. 2022-26H1 电子材料行业固定资产及同比



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

图表 17. 2021-2025 年电子材料行业资本开支/固定资产比例



资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

龙头业绩增速更快，利润贡献与集中度较高

我们进一步选取总市值 300 亿元以上、且部分为各自细分赛道龙头的标的共 24 家，对其 26H1 业绩变化进行梳理。截至 2026 年 9 月 30 日，24 家标的合计总市值为 12,073.97 亿元。从营收和归母净利润增速看，24 家标的 26H1 营业总收入合计 419.47 亿元（同比+30.25%）、归母净利润合计 36.77 亿元（同比+29.96%），增速均高于 69 家标的整体（+28.97%/+24.11%）。从行业占比看，24 家标的 26H1 营收、归母净利润占 69 家整体的比重分别为 53.56%、56.49%，较上年同期的 53.03%、53.95%分别提升 0.53pct、2.54pct。从 26H1 较 25H1 增量贡献看，24 家标的占 69 家营收、归母净利润增量的比重分别达 55.38%、67.03%。综上所述，我们认为电子材料企业龙头业绩增速更快、利润端贡献及集中度提升更为明显。

下载日志已记录，仅供内部参考

综合来看，我们认为以上标的中报值得关注的变化集中在三方面。一是 AI 算力与国产替代共振，材料龙头业绩兑现加速：26H1 中船特气六氟化钨量价齐升带动营收/归母同比+83.13%/+95.63%，鼎龙股份 CMP 抛光垫收入同比增长 56.83%、归母+70.21%，江丰电子归母同比+113.61%、广钢气体归母同比+117.73%、安集科技归母同比+41.56%。二是重资产环节收入高增、盈利仍在修复：沪硅产业 300mm 销量增超 90%但尚未扭亏，西安奕材同比减亏 14.98%，立昂微扭亏为盈。三是新品类与全球布局提速：彤程新材半导体光刻胶收入同比增长近 50%、ArF 及 BARC 产品同比增长近 300%，雅克科技前驱体有机配体完全自产、韩国第三工厂预计 2026 年底投产，国瓷材料 MLCC 介质粉体、联瑞新材先进封装球形粉体等受益于 AI 服务器需求放量。

图表 18. 市值 300 亿元以上标的 2026 年中报业绩（总市值截至 2026.9.30）

公司	细分赛道	总市值（亿元）	26H1 营收（亿元）	营收同比（%）	26H1 归母净利润（亿元）	归母同比（%）	26H1 毛利率（%）	26H1 净利率（%）
西安奕材	12 英寸半导体硅片	1,086.98	15.89	22.00	(2.89)	14.98（减亏）	4.25	(18.21)
中船特气	电子特气（六氟化钨、三氟化氮等）	1,009.38	19.04	83.13	3.48	95.63	31.79	18.27
沪硅产业	半导体硅片	772.71	23.17	36.51	(9.65)	亏损扩大	(8.34)	(44.43)
鼎龙股份	CMP 抛光材料、高端晶圆光刻胶	643.96	19.25	11.15	5.29	70.21	58.83	29.26
国瓷材料	电子陶瓷材料	628.74	25.13	16.64	3.63	9.36	37.66	15.37
江丰电子	溅射靶材、半导体零部件	614.81	27.37	30.68	5.40	113.61	30.21	17.26
有研硅	半导体硅材料	588.77	6.65	21.20	1.33	25.71	33.59	23.10
雅克科技	半导体前驱体	575.87	45.13	5.12	5.61	7.29	29.87	14.11
安集科技	CMP 抛光液、湿电子化学品	481.83	15.26	33.72	5.32	41.56	55.63	34.84
先导基电	半导体设备及电子材料	460.53	11.47	64.06	2.10	414.95	19.97	13.11
C 鸿富诚	热管理材料（导热/屏蔽）	439.49	4.35	66.29	1.76	94.60	68.15	40.93
彤程新材	半导体光刻胶、CMP 抛光垫	407.32	21.36	29.10	3.89	10.86	23.05	18.21
广钢气体	电子大宗气体	405.32	13.33	19.62	2.56	117.73	35.38	19.33
有研新材	高纯靶材、稀有金属材料	394.66	61.58	50.35	1.83	40.89	7.42	2.88
臻宝科技	半导体零部件	375.18	4.84	31.98	1.07	25.74	46.73	22.15
珂玛科技	先进陶瓷零部件	366.68	5.92	13.80	0.98	(42.83)	45.59	15.05
立昂微	半导体硅片、功率器件	350.27	20.94	25.72	0.84	扭亏为盈	13.42	3.48
联瑞新材	电子级粉体填料	348.44	6.29	21.21	1.49	7.48	38.04	23.68
南大光电	前驱体、电子特气、光刻胶	341.78	13.68	11.35	2.56	23.10	40.55	22.21
富乐德	半导体洗净服务及覆铜陶瓷载板	336.17	15.86	9.05	2.07	80.30	29.98	12.84
天通股份	电子材料及专用装备	331.79	17.54	10.75	(2.82)	由盈转亏	21.66	(16.33)
中石科技	热管理及电磁屏蔽材料	323.77	8.28	10.66	1.38	13.59	33.78	16.40
中巨芯	电子湿化学品、电子特气	308.90	7.99	40.98	0.14	72.75	14.06	4.73

资料来源：同花顺 iFinD，中银证券

注：按总市值降序排序，总市值截至 2026 年 9 月 30 日

下载日志已记录，仅供内部参考

电子材料行业 2026 年下半年及未来展望

需求端：AI 与存储高景气有望延续，先进技术迭代促进材料需求持续扩大。从下游需求看，如前文所述，WSTS 预计 2026 年下半年以及 2027 年全球半导体市场有望继续维持高增速，存储器与逻辑芯片仍为增长核心，对晶圆制造材料与封装材料的消耗量有望持续提升。中长期来看，先进技术迭代促进材料需求持续扩大，先进制程与先进封装共同推动材料用量与品类扩容。随着逻辑、存储器件向先进节点演进，三维集成和先进封装需求快速增长，工艺步骤大幅增加，推动更高的晶圆制造材料和封装材料消耗需求。根据雅克科技 2026 年半年度报告，半导体制程节点迭代下晶体管走向三维架构，晶圆高深宽比结构数量持续增加，ALD 工序数量持续上涨——存储领域 2D NAND 向多层 3D NAND 升级使 ALD 工艺步骤近乎翻倍，逻辑领域 7nm 及以下 GAA 节点 ALD 工序进一步成倍提升；同时先进封装、三维集成推动 ALD 从前道晶圆制造延伸至后道，在 TSV、HBM、混合键合等工艺场景大规模落地应用。根据 SEMI 数据，2025 年全球封装材料市场销售额同比增长 9.3%，增速高于晶圆制造材料的 5.4%，先进封装相关材料正成为增长最快的方向之一。根据联瑞新材 2026 年半年度报告，异构集成先进封装（Chiplet、HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M8、M9、M10 等）等下游应用持续拉动纳米级球形二氧化硅、液相法球形二氧化硅、Low α 微米/亚微米球形二氧化硅等高端粉体需求。根据鼎龙股份 2026 年半年度报告，公司开展下一代玻璃基板 CMP 抛光垫的研发和市场推广，成功获得板级封装领域重要客户订单，实现在先进封装领域的新突破。

价格端：部分材料进入涨价周期，盈利弹性有望逐渐释放。本轮半导体材料涨价已覆盖硅片、电子特气、靶材、湿电子化学品、封装材料等多个核心品类。从涨价节奏看，虽然部分材料提价已有一定时间，但材料企业多与下游客户签订季度、半年度、年度长协，需结合细分产品规格、应用领域及客户合作情况有序开展价格优化与业务磋商，我们预计材料涨价带来的相关效益有望在 2026 年下半年逐渐体现。从盈利弹性来看，电子特气、溅射靶材等高壁垒品类龙头（如中船特气、江丰电子等）盈利弹性较大，此外大硅片赛道（如沪硅产业、西安奕材等）企业的毛利率有望在 2026 年下半年环比修复。

市占率：材料国产化加速推进，平台化、国际化布局持续深化。本轮下游高景气叠加部分海外供应波动，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。根据有研新材 2026 年半年度报告，国内头部 12 英寸晶圆厂、存储厂建立本土材料供应商白名单机制，优先推进铜、钴、钽、钨、钌等高纯靶材国产化切换，行业进口替代节奏显著提速；钨、镓、锗、高纯钽相关两用物项出口管制细则落地执行，上游超高纯金属原料自主供给优势进一步巩固，倒逼海外晶圆厂主动加大国产靶材导入比例。根据沪硅产业 2026 年半年度报告，公司 300mm 半导体硅片已在逻辑工艺与存储工艺实现产品全覆盖，26H1 太原工厂新增客户 22 家、新增量产产品 42 款；国内硅片市场逐步企稳回暖，预计相关红利将在 26H2 逐步释放。根据中船特气 2026 年半年度报告，公司六氟化钨产品境内实现新增产线全覆盖，境外获得头部客户送样测试与产线全流程验证机会，国产特气加速导入全球供应链。此外，电子材料企业向平台化产业链配套转型，并持续深化国际化布局。根据鼎龙股份 2026 年半年度报告，公司以半导体材料为核心，产品覆盖集成电路制造、先进封装、半导体显示等领域，CMP 抛光垫、抛光液、清洗液及高端晶圆光刻胶协同发展，并拓展大硅片、SiC、先进封装用 TSV 等新应用场景；根据安集科技 2026 年半年度报告，公司围绕化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大产品平台及上游关键原材料持续布局，提升一站式服务能力；根据雅克科技 2026 年半年度报告，公司电子材料产品线覆盖半导体前驱体、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、特种气体等，已构建中国和韩国双研发部门，韩国子公司 UP CHEM 第三工厂预计 2026 年底全面投产、第四工厂已启动规划。

综合来看，受 AI 基础设施、高性能计算与先进存储投资高景气延续，以及半导体材料涨价进一步向报表端传导的双重驱动，叠加新建产能陆续释放、国产化持续推进，我们预计材料企业收入端将维持较快增长，其中先进制程及先进封装相关材料、国产替代兑现节奏较快的品类有望延续领跑态势。

下载日志已记录，仅供内部参考

投资建议

基于下游行业快速发展、先进技术不断迭代以及国产替代大背景，我们认为电子材料领域有望持续迎来发展良机。

1、受益于下游需求增长以及技术不断进步，全球半导体材料市场规模持续扩大，先进材料需求快速提升。在多种关键半导体材料方面，我国企业稳健布局产能与技术研发，竞争力与产销规模有望持续提升。

2、部分半导体材料及原料受益于涨价，下游高景气叠加海外龙头扩产速度较慢、受到原材料供应波动等影响，我国半导体材料行业或迎来国产替代加速的关键窗口期。

推荐：**安集科技、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技、彤程新材、沪硅产业、德邦科技、阳谷华泰**；建议关注：**国瓷材料、华特气体、联瑞新材、中船特气、中巨芯、西安奕材、广钢气体、昊华科技等**。

下载日志已记录，仅供内部参考

风险提示

技术升级迭代的风险。半导体材料行业目前正处于高速发展阶段，材料厂商需要具备持续的研发创新能力及客户合作基础，才能跟上技术迭代需求。若相关材料企业未来不能准确把握客户的需求变化，技术升级迭代进度和成果未达预期，将对公司经营业绩产生影响。

下游需求复苏不及预期的风险。若宏观经济以及消费回暖情况不及预期，将对位于产业链上游相关材料端企业的生产经营产生不利影响。

全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力的风险。若国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及相关材料公司经营业绩造成影响。

下载日志已记录，仅供内部参考

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买　　入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；

增　　持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；

中　　性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；

减　　持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；

中　　性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；

弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

下载日志已记录，仅供内部参考

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司
中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际证券有限公司
香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话:(852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真:(852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处
中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编:100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司
2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司
美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司
注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371